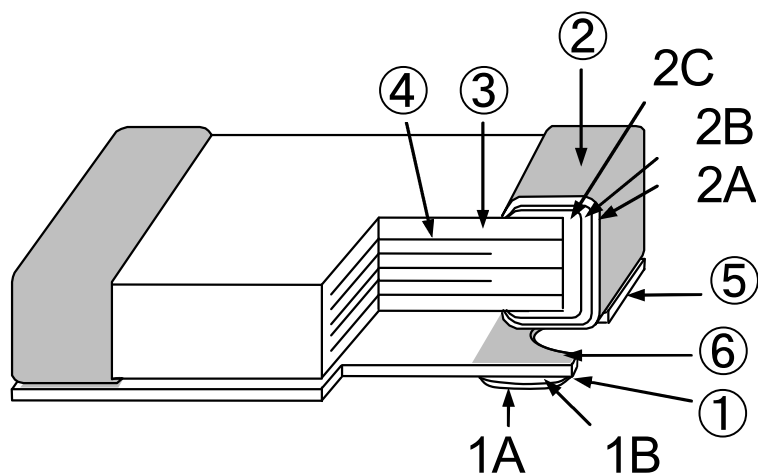


インターポーザ基板付きチップ積層セラミックコンデンサ構造図および材料表
 Structure and Material of Chip Multilayer Ceramic Capacitor on Interposer

<ZRB Series>



No.	名称 Name	主原料 Material
①	外部電極 Termination	
1A	めっき層 Plated layer	すず Tin
1B	下地電極 Electrode	銅 Copper
②	MLCC 外部電極 MLCC Termination	
2A	MLCC めっき層 MLCC Plated layer	すず Tin
2B	MLCC めっき層 MLCC Plated layer	ニッケル Nickel
2C	MLCC 下地電極 MLCC Electrode	銅 Copper
③	MLCC 誘電体素子 MLCC Dielectric layer	チタン酸バリウム系 Ceramic
④	MLCC 内部電極 MLCC Inner electrode	ニッケル Nickel
⑤	インターポーザ基板 Interposer	ガラスエポキシ Glass Epoxy
⑥	接続はんだ Solder	無鉛はんだ(すず・銀・銅系) Lead Free Solder(Tin-Silver-Copper series)